

# 2019年首届包装工程青年学者和研究生学术论坛

## 征文通知

为促进包装工程青年学者的学术交流，提高包装工程研究生的学术水平和学术素养，交流包装行业对我国高等教育人才培养的需求，搭建产学研技术融合平台，促进包装工程专业发展，教育部高等学校轻工类专业教学指导委员会包装工程专业指导组拟于2019年5月中旬，在重庆组织召开“2019年首届包装工程青年学者和研究生学术论坛”。现面向全国包装工程、印刷工程以及相关专业的青年学者、硕士和博士研究生征文，也欢迎相关企业投稿或赞助本届论坛，相关事项通知如下。

### 一、论坛介绍

#### 1. 组织单位

主办单位：教育部高等学校轻工类专业教学指导委员会包装工程专业指导组

承办单位：《包装工程》编辑部

联合承办单位：暨南大学，天津科技大学，哈尔滨商业大学，西安理工大学，江南大学，北京印刷学院，广西大学，郑州大学，湖南工业大学，西南大学等

支持期刊：包装工程，表面技术（EI），材料导报（EI），振动与冲击（EI）等

#### 2. 论坛内容

1) 知名专家和青年学者作学术报告，优秀论文作者学术报告。

2) 邀请相关专家分享：科研团队建设和教学经验、海外留学经验；邀请SCI刊物主编分享学术论文写作和投稿技巧。

3) 行业龙头企业发布高等人才培养需求和技术研发合作需求等。

### 二、征文要求

1) 征文主题：力学、材料学、机械学、农业和食品科学、物流学中所有和包装工程相关的主题。

2) 投稿必须是未发表过的原创论文，会议将组织论文评审，优秀论文将颁发证书，并推荐到《包装工程》或相关EI期刊上发表。

3) 写作和排版格式参照《包装工程》(www.packjour.cn)。

### 三、投稿方式和重要日期

论坛采用电子邮箱收稿：bzgc59@126.com，请在邮件主题注明“研究生论坛投稿”。投稿**截止时间：2019年4月10日**，通知评选结果时间：2019年4月25日。

咨询联系方式：

联系人：梁爱锋、彭颀、陈施含      电话：023-68792294

邮箱：bzgc59@126.com      传真：023-68792283

地市：重庆市九龙坡区渝州路33号      邮编：400039

教育部高等学校轻工类专业教学指导委员会包装工程专业指导组

包装工 编辑部 (代章)

2018年11月13日